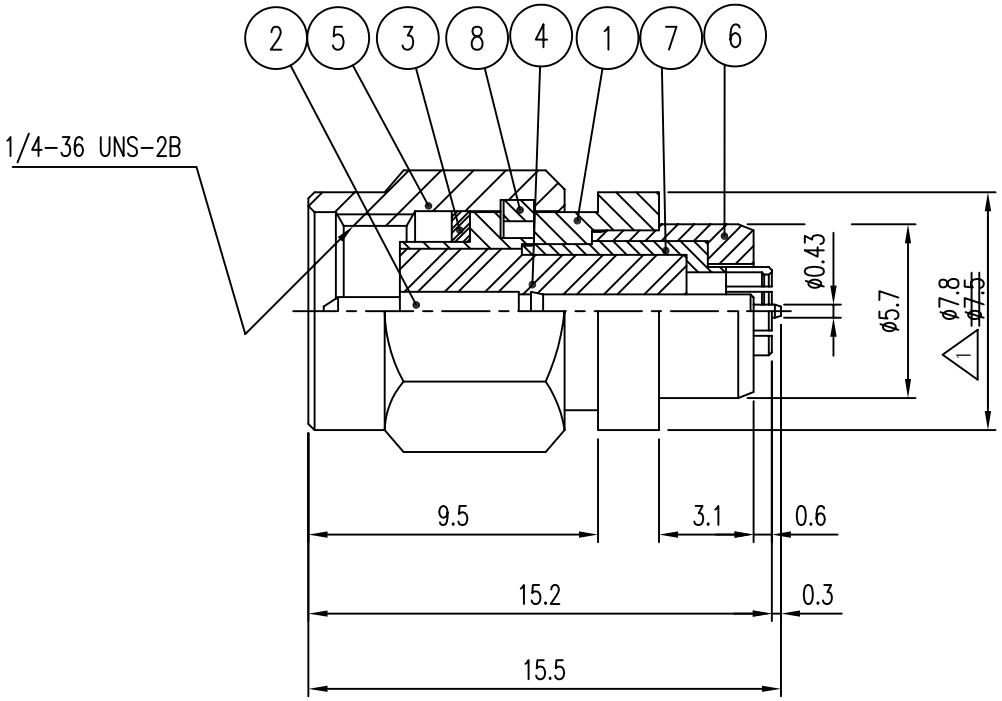
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	[설변No.연구2006-028] 기타 부품과 조립도 치수상이 변경.	김인철	최충락	2006. 2. 7.



품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
8	SPRING RING	1	SUS	부동태 처리	DSR00002-5/1 (R2001)
7	JACK	1	BeCu	Gold Plate	DJA00072-5/1 (JA002)
6	CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00092-5/1 (KA005)
5	COUPLING CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00005-5/2 (K2011)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DAI00024-N/1 (HA216)
3	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00004-N/1 (G2001)
2	CONATCT	1	MBsBD	Gold Plate	DAC00036-5/1 (EA246)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00121-5/1 (D2466)

대체가능재질

공통공차

소수	각도	분수
±0.1	±1°	

재질

열처리

보호피막처리

년월일	2006. 1. 20.
승인	
검도	
제도	
작성부서	연 구 소
척도	4/1
단위	mm
중량	—

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMAP-U.FLP VER.1

A4

도번 AD00336-7/1

K361-797-000